

1	2	3	4
----------	----------	----------	----------

수 정 내 용					
부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일	
1 R	초도작성			2003. 10. 10.	
1	[절번처리No.201201-0011] BODY 내부 닳시배를 추가	김인철	윤재호	2012. 02. 01.	

■ 압착 시 HEX 6.5(+원형) 중간 Tool 사용할 것
- Tool : DEQ01193-N/1

품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
8	BONDING TUBE	1	—	—	ATU00351-N/1 ϕ 8x40 Black
7	SPRING RING	1	SUS	부동태 처리	DSR00002-5/1 (R2001)
6	CAP	1	MBsBD	Nickel Plate	DCU00005-5/2 (K2011)
5	GASKET	1	SILICONE RUB		DGK00004-N/1 (G2001)
4	INSULATOR	1	TEFLON(White)		DIN00093-N/1 (H2016)
3	FERRULE	1	MBsBD	Nickel Plate	DFE00062-5/2 (F5001)
2	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate	DCT00281-5/1 (E2389)
1	BODY	1	MBsBD	Nickel Plate	DBD00132-5/1 (D2358)

대체가능재질		년월일	 KJ COMTECH CO.,LTD. RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017
공통공차	2020. 10. 27.		
소수 각도 분수	승인 I. C. KIM		
재질	검도		
열처리	제도 S. Y. EUN	도명	SMA-PS-LMR 240
보호파막처리	작성부서 연구소	도번	
		적도 2/1 단위 mm 중량	A4

1	2	3	4
----------	----------	----------	----------

■ 포장사양

- 아래 참고 사진과 같이 부품별로 BULK 포장 할 것
-> CONNECTOR / PIN / FERRULE / BONDING TUBE
- 비닐 및 BOX 사이즈 : 발주 수량에 따라 변동

<참고사진>

